

5-104549-7 ✓ AKTIV

AMPMODU | AMPMODU System 50

Interne TE-Nummer 5-104549-7

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board / Board-to-Board, 50

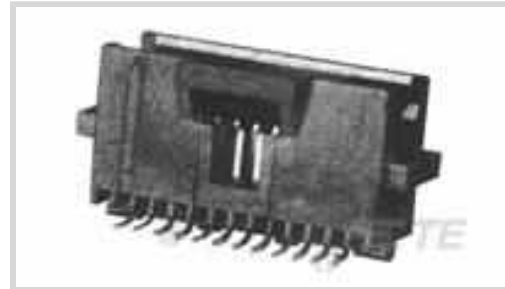
Position, 1.27 mm [.05 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold,

AMPMODU System 50

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen



PCB-Steckverbindermontagetyp: **Stiftleiste für die Leiterplattenmontage**

Montageausrichtung für Leiterplatte: **Vertikal**

Steckverbindersystem: **Draht-an-Leiterplatte, Leiterplatte-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **50**

Raster: **1.27 mm [.05 in]**

Eigenschaften

Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Draht-an-Leiterplatte, Leiterplatte-an-Leiterplatte
Stecksockeltyp	Vollständig ummantelt
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Ladungszustand des Steckverbinderkontakts	Voll bestückt
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Anzahl von Positionen	50
Zeilenanzahl	2

Elektrische Kennwerte

Arbeitsspannung	30 VAC
-----------------	--------

Sonstige Eigenschaften

Profil des Steckverbinders	Standard
Primäre Produktfarbe	Schwarz

Kontaktmerkmale

	150 – 250 µin
--	---------------

Oberfläche des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Matt
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers	Hell
Kontakttyp	Stift
Kontakt-nennstrom (max.)	1 A

Klemmenmerkmale

Anschlussstift- und Restlänge	2.54 mm[.1 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

Typ der Gegensteckführung	Verriegelt
Gegensteckführung	Mit
Panelmontagevorrichtung	Ohne
Art der Leiterplattenmontage	Haltepfosten
Montageausrichtung der Leiterplatte	Mit
Gegensteckarretierung	Mit
Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit
Art der Steckverbindermontage	Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

Raster	1.27 mm[.05 in]
Gehäusematerial	Thermoplast, Thermoplast

Abmessungen

Leiterplattendicke (empfohlen)	1.57 mm
Reihenabstand	2.54 mm[.1 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
---------------------------	----------------------------

Betrieb/Anwendung

Lötverfahrenfunktion	Plattenabstand
Stromkreis Anwendung	Strom und Signale

Industriestandards

Zugelassene Standards	CSA LR7189, UL E28476
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	13
Verpackungs-Typ	Kasten, Rohr

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2023 (235) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2023 (235) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Reflow-Löten tauglich bis 260 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | AMPMODU System 50



Kunden kauften auch diese Produkte





Dokumente

Produktzeichnungen

50 SYS50 S/M HDR DRST SHRDSN

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5-104549-7_W.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5-104549-7_W.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5-104549-7_W.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION3AND4

Englisch

[Fine Pitch Stacking Connectors - 1.27mm AMPMODU System 50 Connectors](#)

Englisch

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch